



# Compression Molding System

**Model CPM1150series**



**Compression molding system specialized  
for high-density package molding**



# 专为高密度封装成型而设计的压缩成型设备

- 面向下一代窄间距 (Bump gap) 结构, 适用于HBM4等高密度先进封装
- 采用适用于微细间隙MUF填充的成型工艺
- 以TOWA自主开发的压缩成型技术为核心, 支持晶圆级与面板级成型
- 单台设备同时兼容颗粒材料与液态树脂 ※CPM1150-HP设备为颗粒或液态可选式 (无法兼用)
- 自研高精度高均匀性颗粒树脂铺撒与图形点胶
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



## SPECIFICATION

Items		Unit	Description					
机型		—	CPM1150-V			CPM1150-HP		
面板·晶圆类型		—	面板·晶圆					
面板·晶圆尺寸	面板	mm	□150—320					
	晶圆	mm	φ 320 (Max.)					
树脂		—	颗粒·液态 (可并用)			颗粒或液态 (选择式)		
机械时间		sec	Approximately 88			Approximately 65		
外形尺寸	模组数量	module	1	2	1	2	3	4
	宽度	mm	3,910	4,590	5,490	6,170	6,850	7,530
	纵深	mm	2,180	2,180	2,168	2,168	2,168	2,168
	高度	mm	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	7.0	10.6	10.2	13.8	17.4	21.0
每模成形晶圆数量		workpiece	1	2	1	2	3	4
料盒放置空间		—	Panel : Input / Output 2 cassette each Wafer : 2 loadport					
合模压力		kN/(tf)	98.0—1,470.0 / 10.0—150.0					
合模速度		mm/sec	50 (Max.)					
使用分离膜的宽度		mm	440 (Max.)					

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求, 另行协商
- 外形尺寸为颗粒树脂规格的产品



[ 东和半导体设备 (上海) 有限公司 ]

中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A

TEL 021-6888-6860

### [ Overseas Sales Contacts ]

#### ■ Japan / Headquarters

· TOWA Corporation

#### ■ China

· TOWA (Shanghai) Co., Ltd.  
· Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.  
· TOWA Taiwan Co., Ltd.

#### ■ Korea

· TOWA Korea Co., Ltd.

#### ■ Singapore

· TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

#### ■ Malaysia

· TOWA Malaysia Sales &amp; Services Sdn. Bhd.

#### ■ Thailand

· TOWA THAI COMPANY LIMITED

#### ■ Philippines

· TOWA Semiconductor Equipment  
Philippines Corp.

#### ■ India

· TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

#### ■ Germany

· TOWA Europe GmbH

#### ■ Netherlands

· TOWA Europe B.V.

#### ■ the United States

· TOWA USA Corporation

